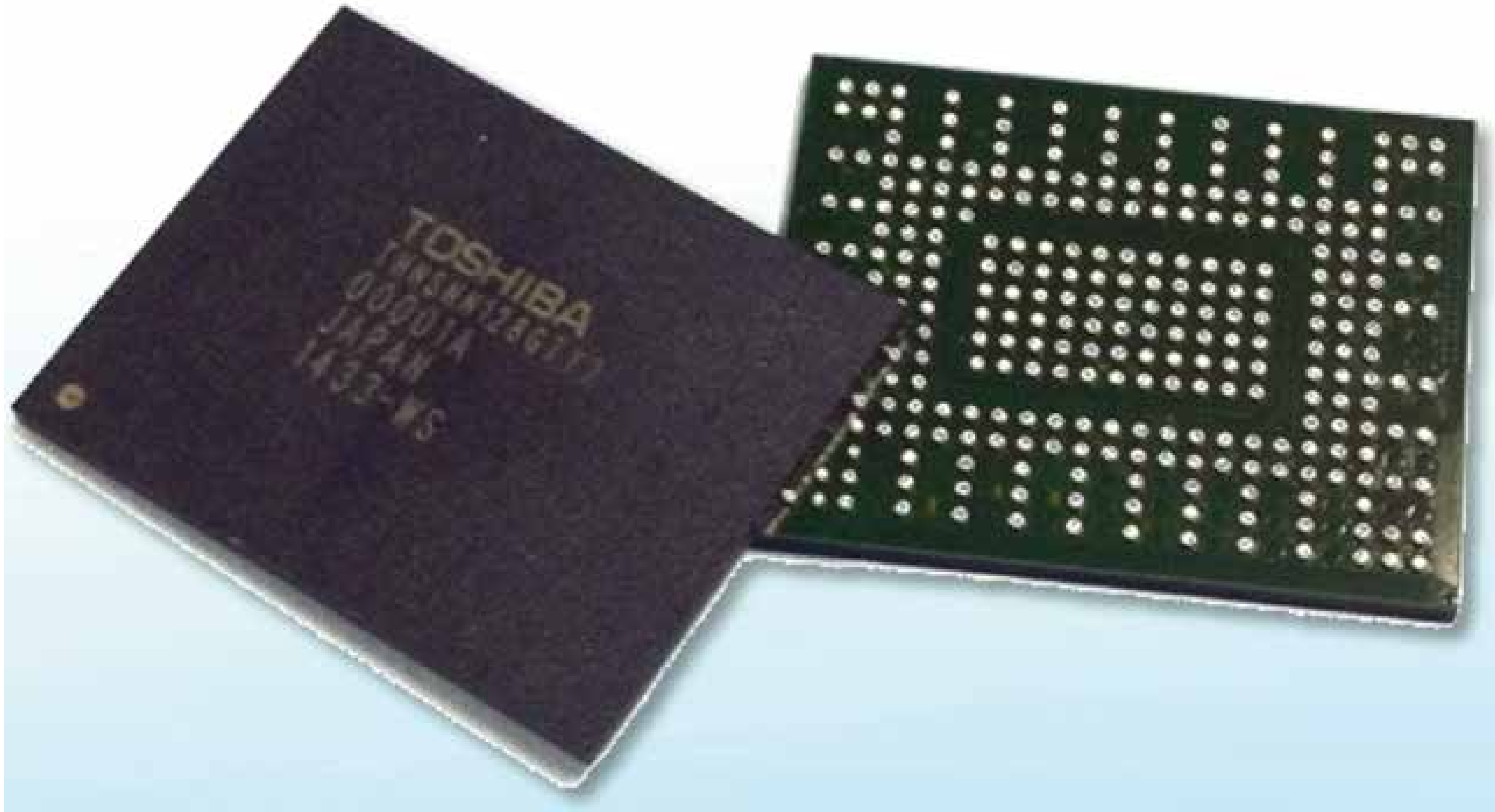


BGA SSD BG系列产品规格摘要

全球首款BGA封装PCI-e SSD

外形规格		BGA SSD (M.2 1620*)		M.2 2230*	
容量		128 GB	256 GB	128 GB	256 GB
尺寸	W	16mm	16mm	30mm	30mm
	D	20mm	20mm	22mm	22mm
	H	1.40mm	1.65mm	2.2mm	2.45mm
接口标准	物理接口	PCI Express 3.0版			
	指令协议	NVMe Express 1.1版			

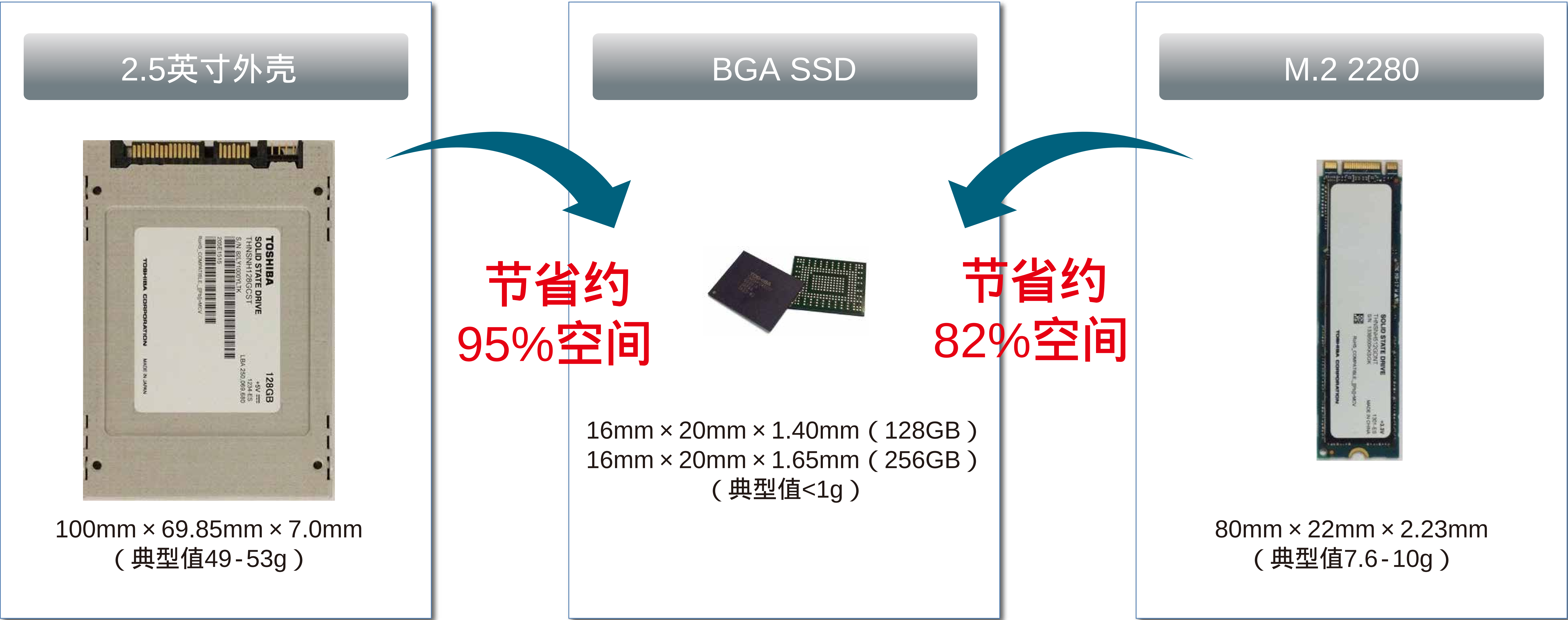


* 东芝拟采用PCI-SIG外形规格M.2 1620和M.2 2230。最终规格请参考东芝信息。



BGA SSD产品优势

采用高密度封装技术，实现最高256GB容量
占用空间更小，让设备更加轻薄！



TOSHIBA

Leading Innovation >>>

BGA SSD产品优势

M.2 2230外形规格，全球最小可拆卸型SSD!

- 全球首款M.2 2230 SSD
- 将BGA SSD安装在M.2 2230 PCB板上，便于在主板上进行更换
- 高度更低，最大高度仅为2.45mm

M.2 2230

30mm × 22mm × 2.20mm (128GB)

30mm × 22mm × 2.45mm (256GB)

